

2026年3月期 第1四半期（2025年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2025年7月31日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2026年3月期 第1四半期 連結決算の概要

2025年7月31日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



改めまして、川本でございます。
私から、2026年3月期、第1四半期 連結決算の概要をご説明いたします。

損益状況（四半期）

(億円)

	FY2025				FY2026	vs.	vs.
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	FY2025 Q4	FY2025 Q1
売上高	5,550	5,665	6,545	6,554	5,495	-16.1%	-1.0%
売上総利益	2,640	2,599	3,117	3,105	2,539	-18.2%	-3.8%
売上総利益率	47.6%	45.9%	47.6%	47.4%	46.2%	-1.2pts	-1.4pts
販管費	982	1,117	1,121	1,267	1,092	-13.8%	+11.2%
営業利益	1,657	1,481	1,996	1,837	1,446	-21.3%	-12.7%
営業利益率	29.9%	26.2%	30.5%	28.0%	26.3%	-1.7pts	-3.6pts
税金等調整前当期純利益	1,672	1,536	2,001	1,851	1,519	-17.9%	-9.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,261	1,177	1,572	1,429	1,178	-17.6%	-6.6%
研究開発費	534	620	618	727	621	-14.5%	+16.3%
設備投資額	239	533	502	346	528	+52.7%	+120.2%
減価償却費	132	145	160	183	171	-6.6%	+30.0%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

こちらは、四半期ごとの「損益状況」です。

青枠の部分を中心にご覧ください。

第1四半期の売上高は、顧客の設備投資の一服感もあり、前四半期比 16.1%減少の 5,495億円となりました。

売上総利益は、前四半期比18.2%減少の2,539億円。

売上総利益率は、売上高減少に伴う固定費比率上昇により、前四半期比1.2ポイント減少の46.2%となりました。

営業利益は、前四半期比21.3%減少の、1,446億円。

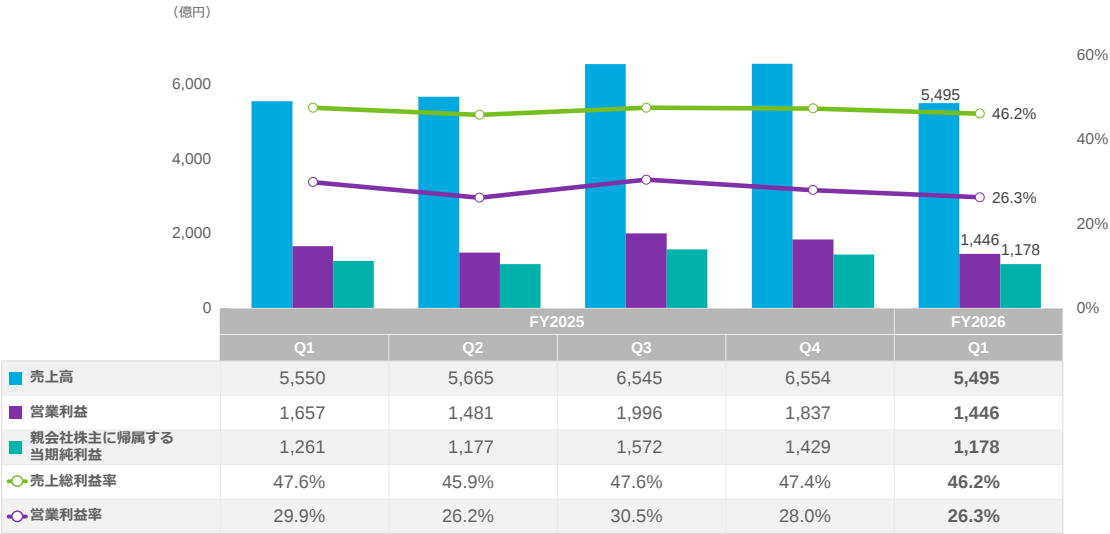
営業利益率は、主に、前述した売上総利益率の減少により、前四半期比1.7ポイント減少の26.3%となりました。

税金等調整前当期純利益は、前四半期比17.9%減少の1,519億円、

また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前四半期比 17.6%減少の 1,178億円となりました。

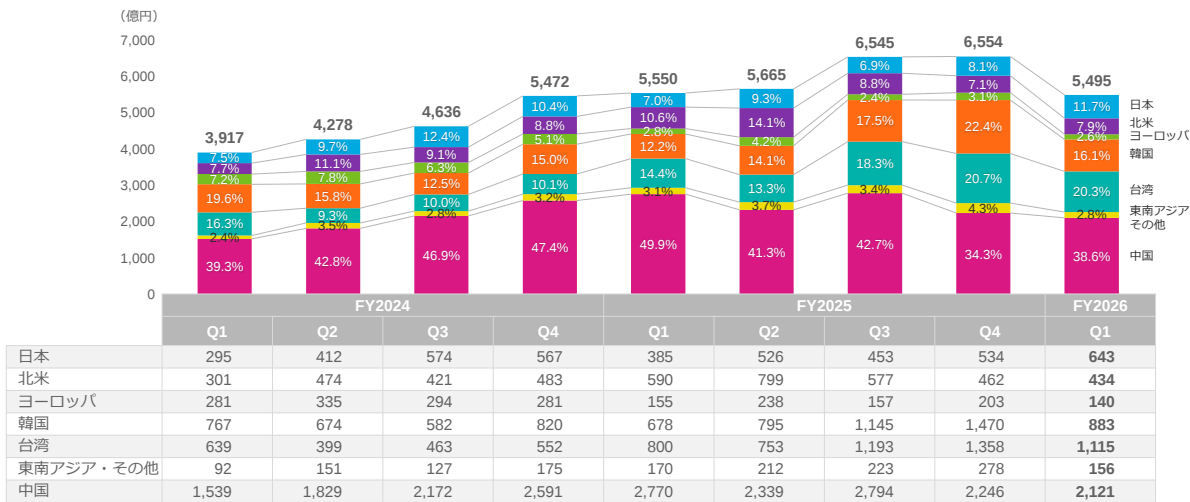
第1四半期の設備投資額は528億円でした。竣工いたしました東京エレクトロン宮城の新開発棟が主な増加内訳でございます。

損益状況（四半期）



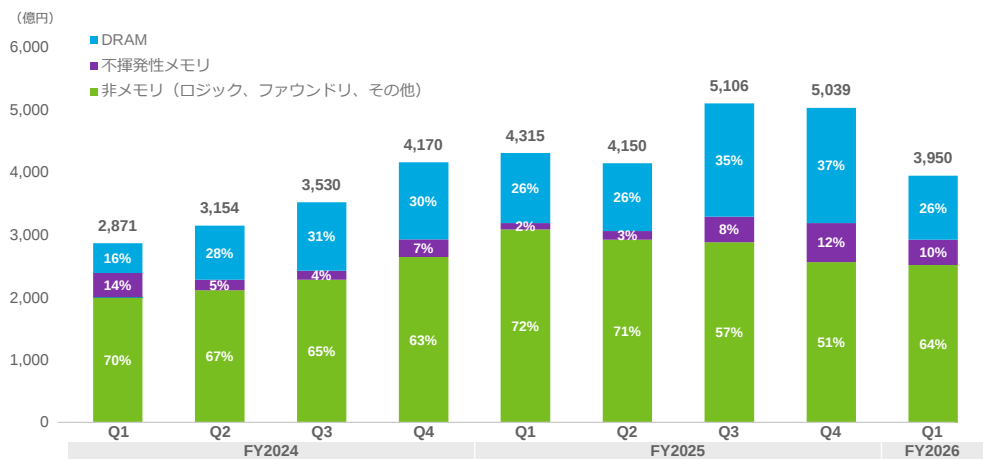
こちらのグラフは、先ほどご説明させていただいた業績を時系列で示しておりますので、ご確認ください。

地域別売上高構成比（四半期）



こちらは、「地域別売上高」です。
第1四半期の構成比につきましては、日本で前四半期比3.6ポイント増加し11.7%、韓国で前四半期比6.3ポイント減少し16.1%となりました。
中国向けの売上高構成比につきましては、第1四半期の比率は38.6%となり、前四半期に続き、40%を下回る水準でございました。

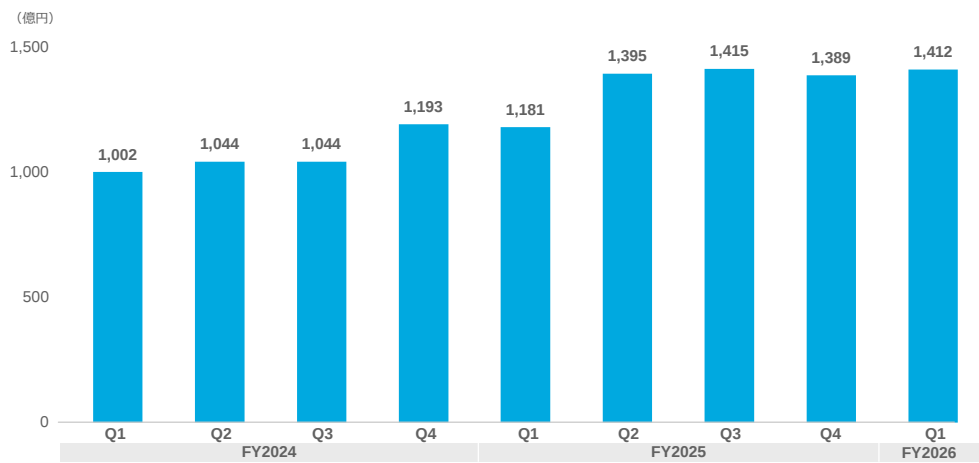
SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置
2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

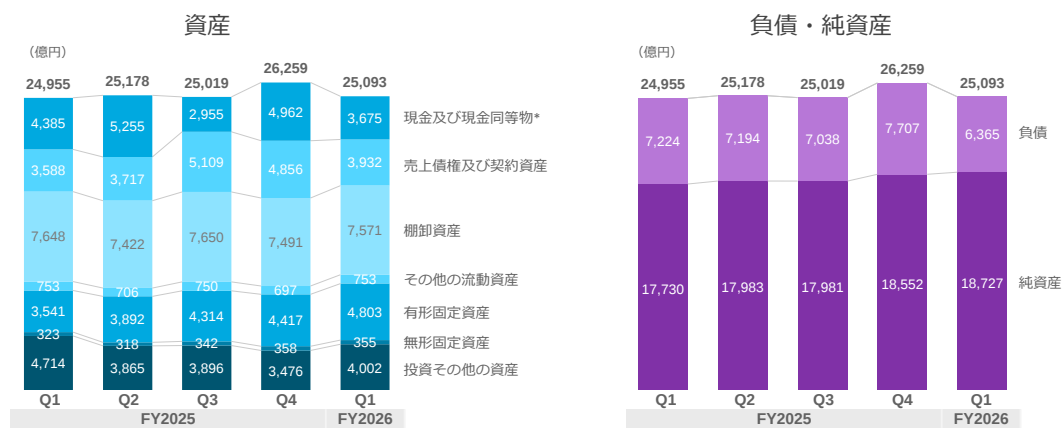
こちらは、「SPE新規装置のアプリケーション別 売上構成比」です。
第1四半期の構成比は、下から非メモリ 64%、不揮発性メモリ 10%、DRAM 26%となりました。
非メモリ向けの売上は前四半期と同水準となりましたが、DRAM向けの売上は、前四半期における顧客の設備投資の集中もあり、構成比は前四半期比11ポイント減少となりました。

フィールドソリューション売上高（四半期）



こちらは、「フィールドソリューション売上高」です。
第1四半期は前四半期比22億円増加の、1,412億円となりました。
先端領域を中心に顧客稼働率は高く、パーツ・サービス、改造案件ともに、堅調に推移いたしました。

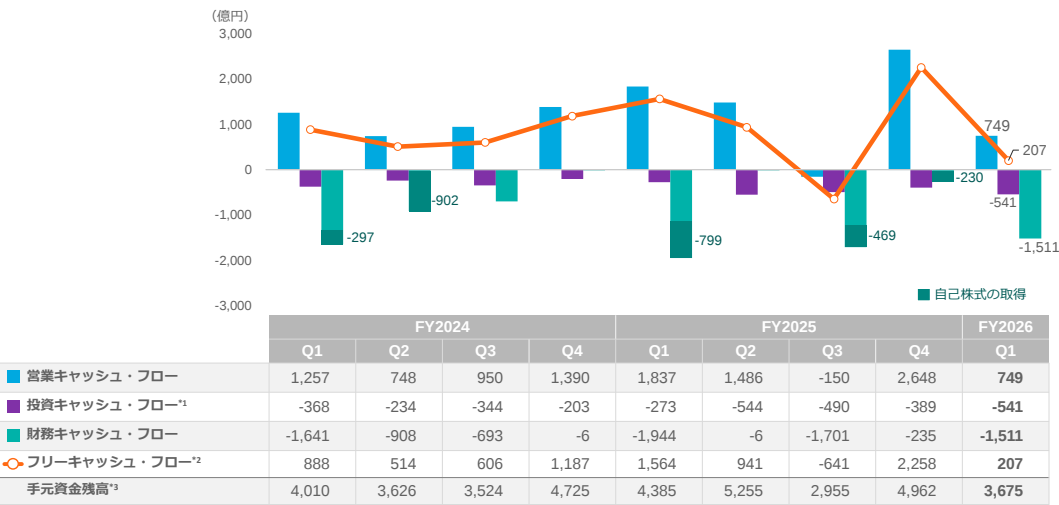
貸借対照表（四半期）



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

続きまして、「貸借対照表」をご説明いたします。
資産合計は、2兆5,093億円となりました。
現金同等物は、3,675億円。
前四半期から1,287億円減少いたしました。
主に、株主さまへの配当金の支払いや納税等によるものです。
売上債権及び契約資産は、前四半期比923億円減少の3,932億円。
棚卸資産は、前四半期比79億円増加の7,571億円。
投資その他の資産は、主に株式の時価上昇により、前四半期から525億円増加し、4,002億円となりました。
続いて、右側の負債・純資産に移ります。
負債は、前四半期から1,341億円減少の6,365億円となりました。
先ほど申し上げましたとおり、法人税等の納付により、未払法人税等が減少したことによるものです。
純資産は、前四半期比175億円増加の1兆8,727億円となりました。
なお、自己資本比率は 74.0%となりました。

キャッシュ・フロー（四半期）



^{*1} 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。
^{*2} フリーキャッシュ・フロー＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）
^{*3} 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

続きまして、「キャッシュ・フロー」をご説明いたします。
この四半期における営業キャッシュフロー獲得は、749億円でした。
投資キャッシュフローの支出は、主に、固定資産の取得により、541億円。
財務キャッシュフローの支出は、主に、配当金の支払いにより、1,511億円。
また、フリーキャッシュフローは、207億円の収入となりました。
私からのご説明は以上です。ありがとうございました。

事業環境および業績予想

2025年7月31日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



河合でございます。

改めまして、本日はご参加いただきありがとうございます。

私からは、「事業環境 および 業績予想」について、ご説明致します。

市場環境と事業進捗

- FY2026 Q1：計画通り進捗
 - 売上・利益とも、ほぼ計画どおり
 - 売上高 5,495億円、営業利益 1,446億円、営業利益率 26.3%
 - POR*の獲得や、将来成長に向けた戦略製品の開発評価も順調
 - 新規 低抵抗メタル成膜装置、多くのNAND顧客において評価進捗
 - レーザーリフトオフを含む3Dインテグレーション装置、商談進行中
 - 東京エレクトロン宮城 新開発棟 竣工
- FY2026上期業績見通し：変更なし
 - 売上高 1兆1,500億円、営業利益 2,880億円、営業利益率 25.0%
- CY2025 WFE：ほぼ想定通り
 - 為替等の動向を反映し、4月想定の\$110Bから\$115Bに修正

* POR (Process of Record)：顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

Investor Relations / July 31, 2025

TEL

12

今回、事業環境に変化が見られましたので、WFEの見通し、および業績予想を修正いたしました。事業進捗とあわせ、まずはそれらについてご説明します。

FY2026 第1四半期の実績は、売上・利益とも、ほぼ計画どおりに進捗しました。戦略製品の販売展開、および、POR獲得に向けた開発・評価活動も順調に進みました。新材料の低抵抗メタル成膜装置について、多くのNAND顧客においてバッチ炉で評価が進んでおります。

昨年12月にリリースした、レーザーリフトオフ装置を含む、一連の3Dインテグレーション装置についても、ロジックやNANDのお客様において商談が進行しています。また、4月に、主力製品であるエッチング装置の開発強化に向け、宮城の新開発棟を竣工しました。

FY2026上期の業績見通しにつきましても、変更はございません。売上高 1兆1,500億円、営業利益 2,880億円、営業利益率 25.0%を予想しています。

CY2025のWFEにつきましても、投資の入り繰りはありますが、ほぼ想定通りとみています。

為替変動などの影響も反映し、前年比微増の115Bドル程度とみています。

市場環境と事業進捗

■ CY2026上半期（1月～6月）の動向：

顧客の歩留まり改善による生産性向上、利益を意識した需給バランスの最適化、先行投資から着実な投資への切り替えなどにより、FYベース（FY2026）のWFEはマイナス5%成長と予測を修正

- 一部先端ロジック顧客の設備投資の見直し
- 中国新興半導体メーカーによるレガシー投資の縮小
- NANDにおける、需給バランスを慎重に見た投資計画の変更
- HBM*需要は旺盛なものの、生産技術および顧客の歩留まり向上による投資計画の見直し
- DRAM DDR4からDDR5への全量切り替え投資タイミングの遅延

* HBM (High Bandwidth Memory) : 高帯域幅DRAM

Investor Relations / July 31, 2025

TEL

13

一方、半導体デバイス需要の見方に変更はないものの、CY2026上半期のWFEにつきましては、顧客の歩留まり向上による生産性向上、利益を意識した需給バランスの最適化、先行投資から着実な投資への切り替えなどにより、投資動向に変化が見られ、結果、FYベースのWFEは、前年比マイナス5%と予測を修正します。各セグメントの見直し傾向は、ご覧の通りです。

FY2026 業績予想

(億円)

	FY2025 (実績)	FY2026 (新予想)					ご参考：FY2026 (4/30時点予想)	
		H1	H2	通期	vs FY2025	修正額*	H2	通期
売上高	24,315	11,500	12,000	23,500	-3.4%	-2,500	14,500	26,000
売上総利益	11,462	5,270	5,390	10,660	-7.0%	-1,620	7,010	12,280
売上総利益率	47.1%	45.8%	44.9%	45.4%	-1.7pts	-1.8 pts	48.3%	47.2%
販管費	4,489	2,390	2,570	4,960	+10.5%	-50	2,620	5,010
研究開発費	2,500	1,400	1,550	2,950	+18.0%	-50	1,600	3,000
研究開発費以外の販管費	1,989	990	1,020	2,010	+1.0%	0	1,020	2,010
営業利益	6,973	2,880	2,820	5,700	-18.3%	-1,570	4,390	7,270
営業利益率	28.7%	25.0%	23.5%	24.3%	-4.4pts	-3.7pts	30.3%	28.0%
税金等調整前当期純利益	7,061	2,930	2,860	5,790	-18.0%	-1,570	4,430	7,360
親会社株主に帰属する当期純利益	5,441	2,240	2,200	4,440	-18.4%	-1,220	3,420	5,660
1株当たり当期純利益（円）	1,182.40	488.93	-	969.12	-213.28	-266.39	-	1,235.51

* 2025年4月30日に発表した通期業績予想からの修正額を示しています。

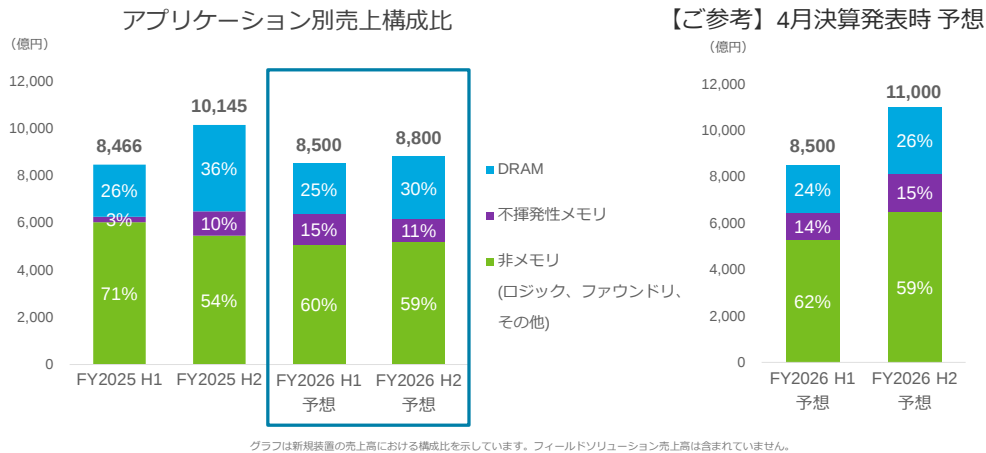
足元の顧客投資状況を踏まえ、下期の業績予想を修正

FYベースのWFEの下方修正にともない、当社のFY2026通期の業績予想を、売上高 2兆3,500億円に、営業利益率は 24.3%に修正します。

下方修正になりますが、売上総利益は、2年連続で1兆円を超える見通しです。

なお、2026年1月～6月の半年間のWFEはこれまでご説明してきた通りですが、AIサーバー向けをテクノロジードライバーとする半導体需要の拡大の流れは一切変わっておらず、研究開発投資につきましては、3ヵ月前にお伝えした額とほぼ同等の2,950億円を計画しております。

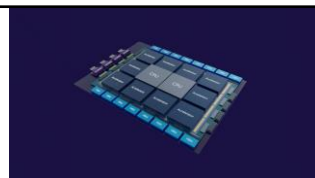
FY2026 SPE新規装置売上予想



最新顧客投資動向の変化により、下期予想を修正

こちらは、見直しました、今期 FY2026のSPE 新規装置の 売上予想です。
今下期の新規装置の売上は、上期から微増の、8,800億円となる見込みです。
今回の修正は、主に、お客様の 生産技術の向上や、投資戦略の変更によるもので、
必ずしもデバイス需要とはリンクしませんが、アプリケーションごとの内訳は、ご覧
の通りです。

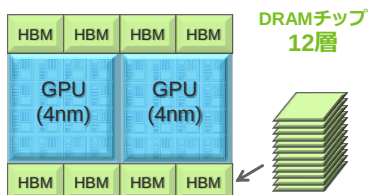
AIサーバーに不可欠な最先端半導体 ＜CY2026（FY2027）の成長ドライバー＞



CY2025

トランジスタ数 **約2,000億個**

メモリ容量 **288ギガバイト**

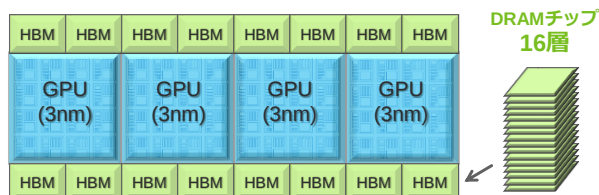


GPU : Graphic Processing Unit
HBM : High Bandwidth Memory

CY2027

トランジスタ数 **約5,000億個**

メモリ容量 **1テラバイト（1,024ギガバイト）**



TEL estimates

この先2年でトランジスタ数は2.5倍に、メモリ容量は4倍に増加。
GPUは4nm世代×2個から3nm世代×4個に、HBMは12層から16層に技術革新が進む

Investor Relations / July 31, 2025

TEL

16

前述のように、足元では、お客様の投資動向の変化もあり、CY2026のWFEについては現在精査中ですが、CY2027にリリースが予定されている、最先端のAIサーバー向けデバイス需要に牽引され半導体市場が継続的に拡大する、という見方に変更ございません。

AIサーバーには高いコンピューティングパワー、すなわち、大量のデータを高速に演算処理する能力が求められます。

そこに搭載されるGPUは、CY2027には、現在の4ナノチップ2個から、3ナノチップ4個になり、トランジスタの数は、5,000億個、現在の約2.5倍になります。

HBMも、その個数が増え、構成するDRAMチップの微細化と積層数の増加で、現在の約4倍の容量になり、いよいよギガバイトからテラバイトの時代が到来します。

次世代AIコンピュータプラットフォームの実現に向けた投資が、CY2026後半から拡大していくことが期待されます。

微細化やアドバンスドパッケージなど、当社の事業機会もますます広がっていきます。

FY2026 研究開発費・設備投資計画



宮城県黒川郡
2025年4月 竣工



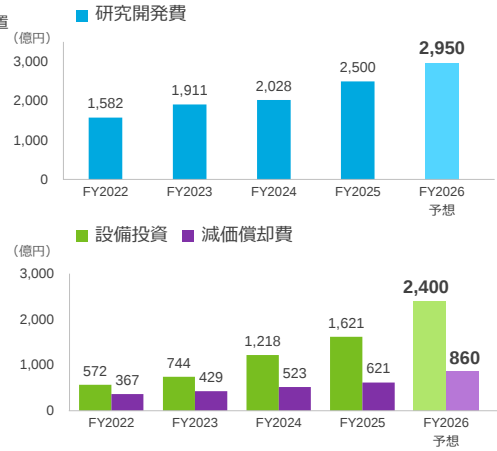
岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定



熊本県合志市
2025年秋 竣工予定



宮城県黒川郡
2027年夏 竣工予定



AIサーバー向け半導体が技術革新を牽引し、半導体の需要は拡大。
研究開発・設備投資は予定通り実施

次に、「研究開発費と設備投資の計画」についてです。

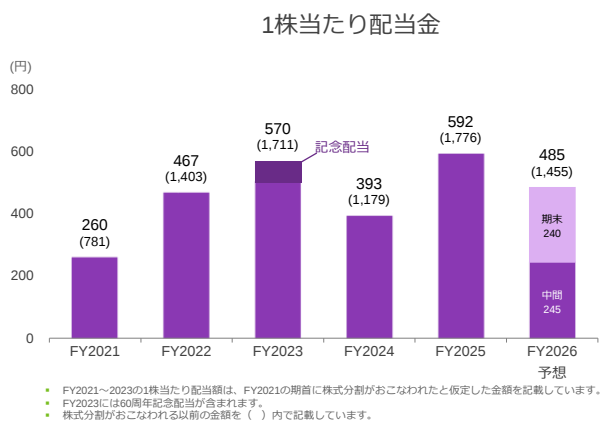
今期は、4月に竣工した宮城の新開発棟を皮切りに、この秋には、熊本の新開発棟と、岩手の生産・物流センターが竣工予定です。

次世代のスマートマニュファクチャリング構想を採り入れた、宮城の生産新棟も6月より着工しました。

FY2026の研究開発費は、先程お話しした通り、2,950億円を計画しています。

設備投資、減価償却費は、期初と変わらず、それぞれ、2,400億円、860億円を見込んでおります。

FY2026 配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

1株当たり通期配当は485円を予定

最後に、「配当予想」についてです。
下期 業績予想の修正を反映し、今期の1株当たりの配当は、通期 485円 を予定しております。
なお、期中の手元資金の状況と、資本効率のバランスを勘案しつつ、機動的に自社株買いの実施を検討してまいります。
私からのご説明は以上です。
ご静聴ありがとうございました。

